2018年3月期　第2四半期　決算説明会

開催日：2017年11月6日（月）

2017年11月6日にアナリスト・機関投資家の方々を対象とした
「2018年3月期　第2四半期　決算説明会」を開催いたしました。
決算概要、業績予想、第9次中期経営計画（Challenge 1500）進捗について
説明いたしました。
内容につきましては、次ページ以降に掲載しておりますのでご覧ください。

2018年3月期 第2四半期 決算説明資料

2017年11月6日

サンワテクノス株式会社

URL : http://www.sunwa.co.jp/

本資料取扱い上の注意点

- この資料には、当社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想見通しの記述が含まれています。

- これらの記述は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ経済や当社の関連する業界動向、新たな技術の進展等により変動することがあり得ます。

- 従いまして、実際の業績等が記載の予想数値と異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。

- 2018年3月期 第2四半期 決算概要
- 2018年3月期 業績予想
- 第9次中期経営計画(Challenge 1500)進捗

- 2018年3月期 第2四半期 決算概要
- 2018年3月期 業績予想
- 第9次中期経営計画(Challenge 1500)進捗

連結決算の概要について

・前年同期比で**増収増益**
（過去最高の売上高、純利益）

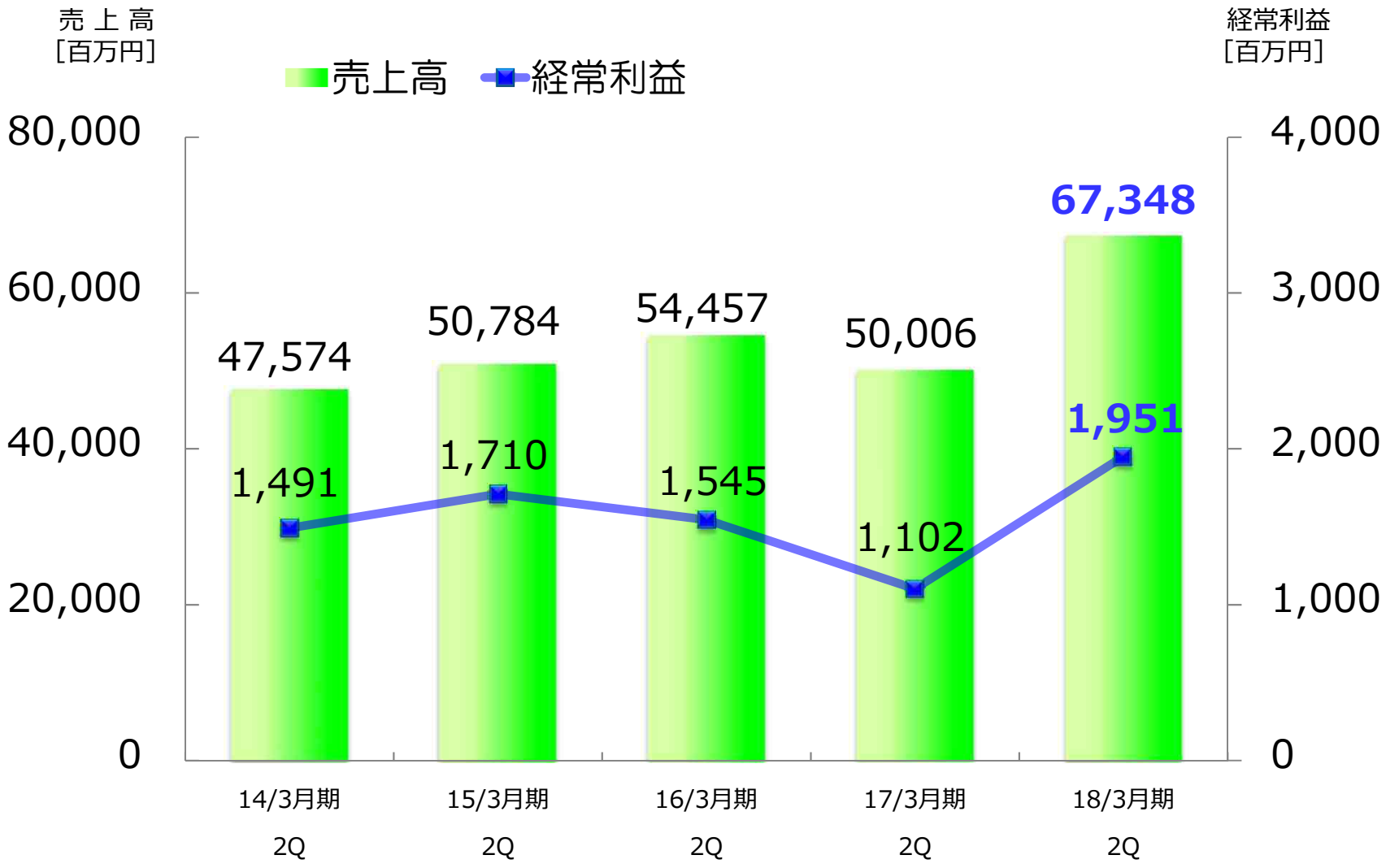
（単位：百万円）

	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間	増減額	対前年同四半期増減率
売上高	50,006	67,348	17,342	34.7%
営業利益	1,082	1,773	691	63.9%
経常利益	1,102	1,951	848	76.9%
四半期純利益（※）	763	1,359	595	78.0%
1株当たり四半期純利益	54.47円	98.11円	43.64円	80.1%

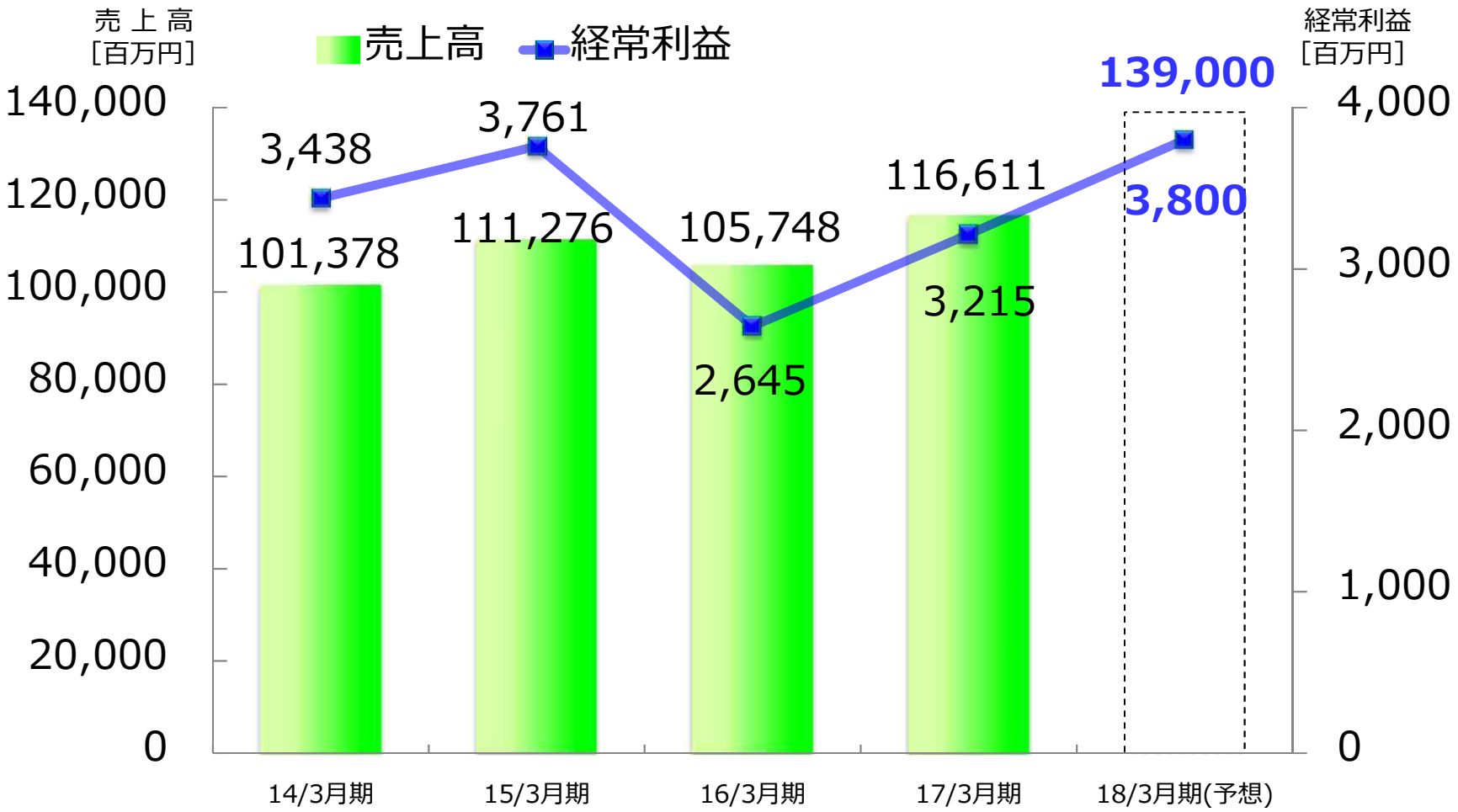
【連結決算の概要について】
スマートフォン向け及び自動車向けの需要が堅調に推移しており、また、半導体関連業界・産業機械業界についても、ロボットや半導体製造装置等の市場の好調は続いております。このような環境の中で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、前年同期を上回り、過去最高の売上高、純利益となりました。

（※）親会社株主に帰属する四半期純利益

売上高及び経常利益 第２四半期累計推移（連結）



売上高及び経常利益推移（連結）



部門別 売上高推移表

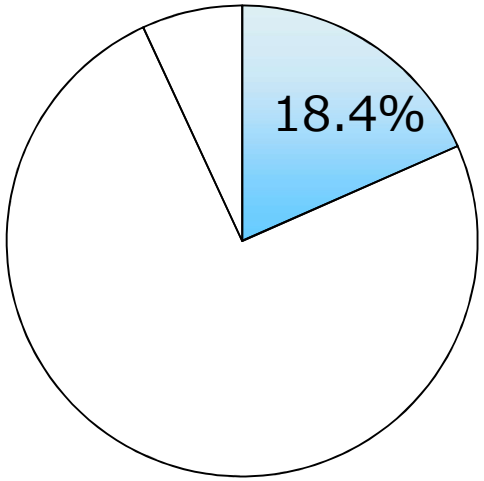
電機部門
電子部門
機械部門
（単位：百万円）
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
101,378
6,975
69,643
24,759
111,276
8,141
80,473
22,660
105,748
9,084
77,593
19,069
116,611
10,055
85,819
20,736
139,000
13,300
100,800
24,900
14/3月期
15/3月期
16/3月期
17/3月期
18/3月期
（予想）

部門別の概要【電機部門】

■売上高

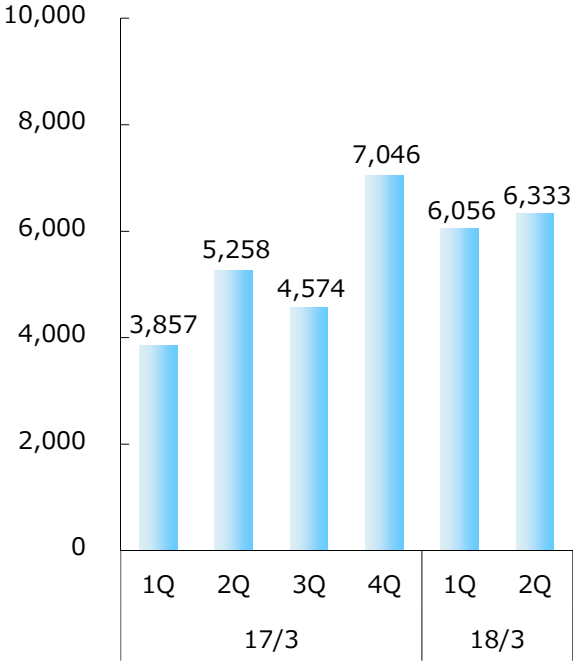
当第2四半期累計期間　12,390百万円（前期比35.9%増）
当第2四半期会計期間　6,333百万円（前期比20.4%増）

■売上高構成比率
（当第2四半期累計期間）

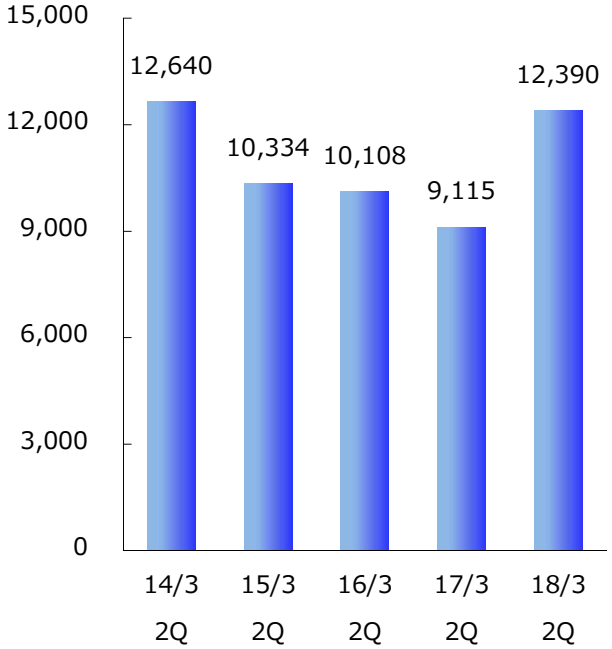


■売上高推移表（単位：百万円）

<四半期会計期間>



<四半期累計期間>



■point

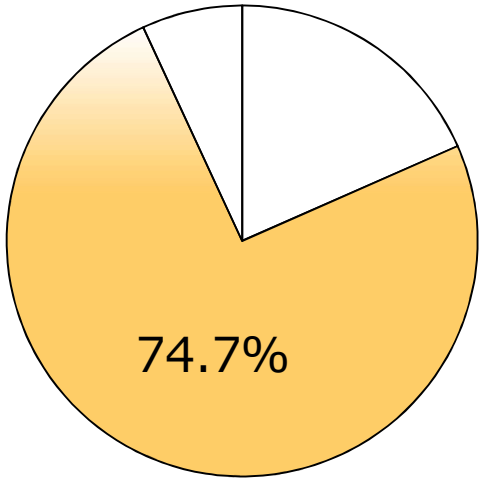
・産業機械業界の製造設備向けの電機品の販売が増加

部門別の概要【電子部門】

■売上高

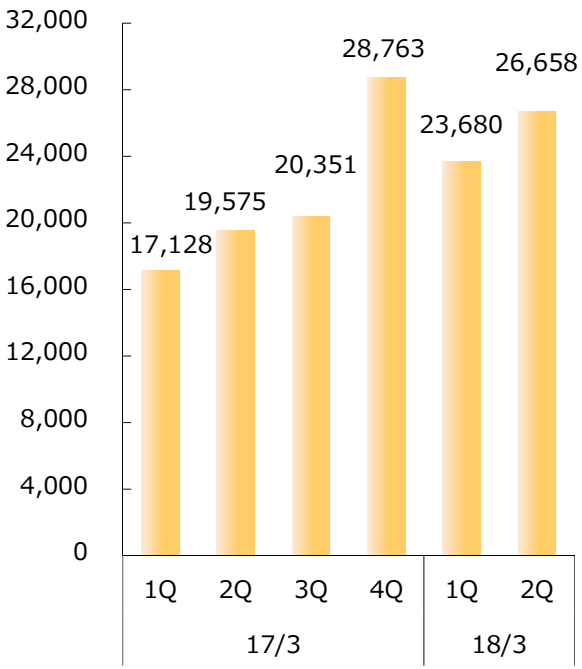
当第2四半期累計期間　50,339百万円（前期比37.1%増）
当第2四半期会計期間　26,658百万円（前期比36.2%増）

■売上高構成比率
（当第2四半期累計期間）

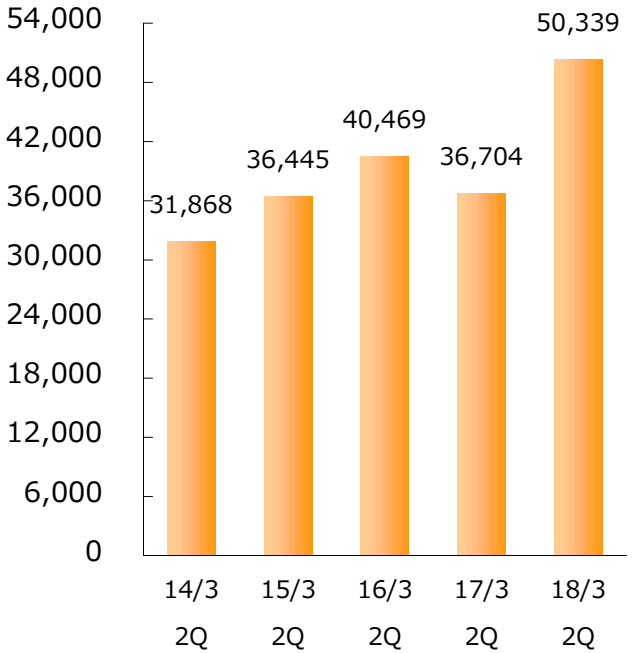


■売上高推移表（単位：百万円）

<四半期会計期間>



<四半期累計期間>



■point

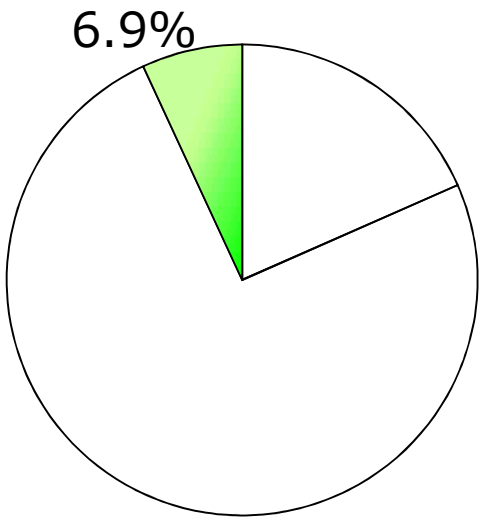
・自動車関連業界、産業機械業界向けの電子部品の販売が増加
・社会インフラ設備向けの電子機器の販売が増加

部門別の概要【機械部門】

■売上高

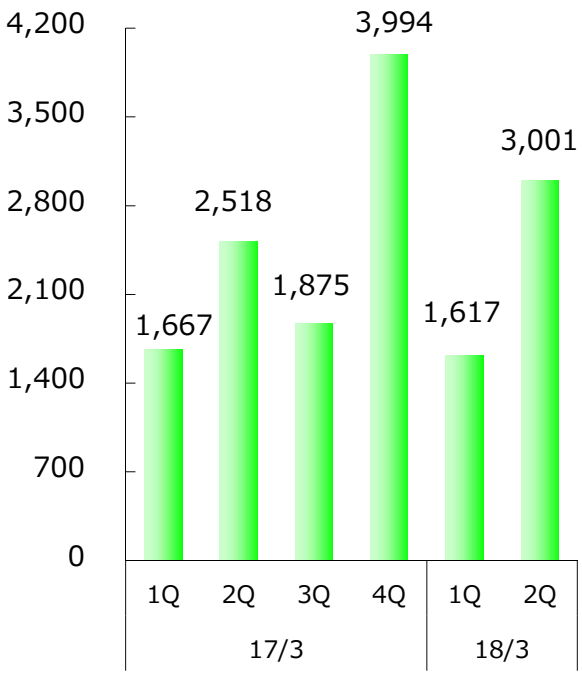
当第2四半期累計期間　4,619百万円（前期比10.4%増）
当第2四半期会計期間　3,001百万円（前期比19.2%増）

■売上高構成比率
（当第2四半期累計期間）

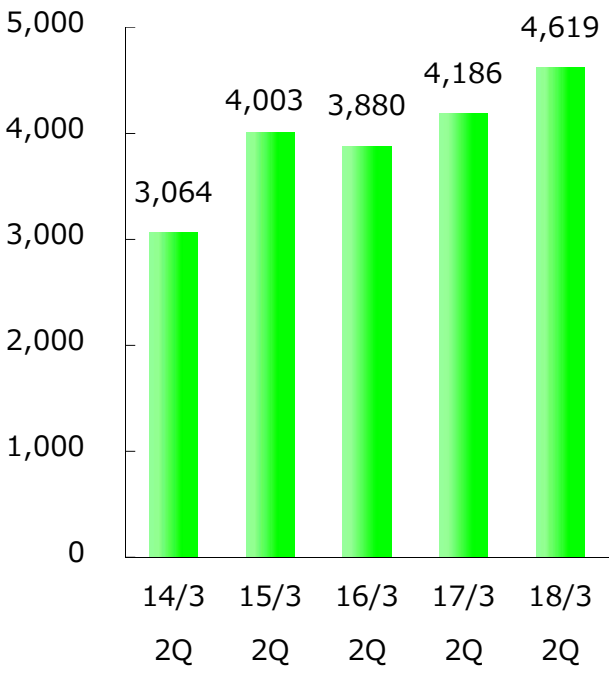


■売上高推移表　（単位：百万円）

<四半期会計期間>



<四半期累計期間>

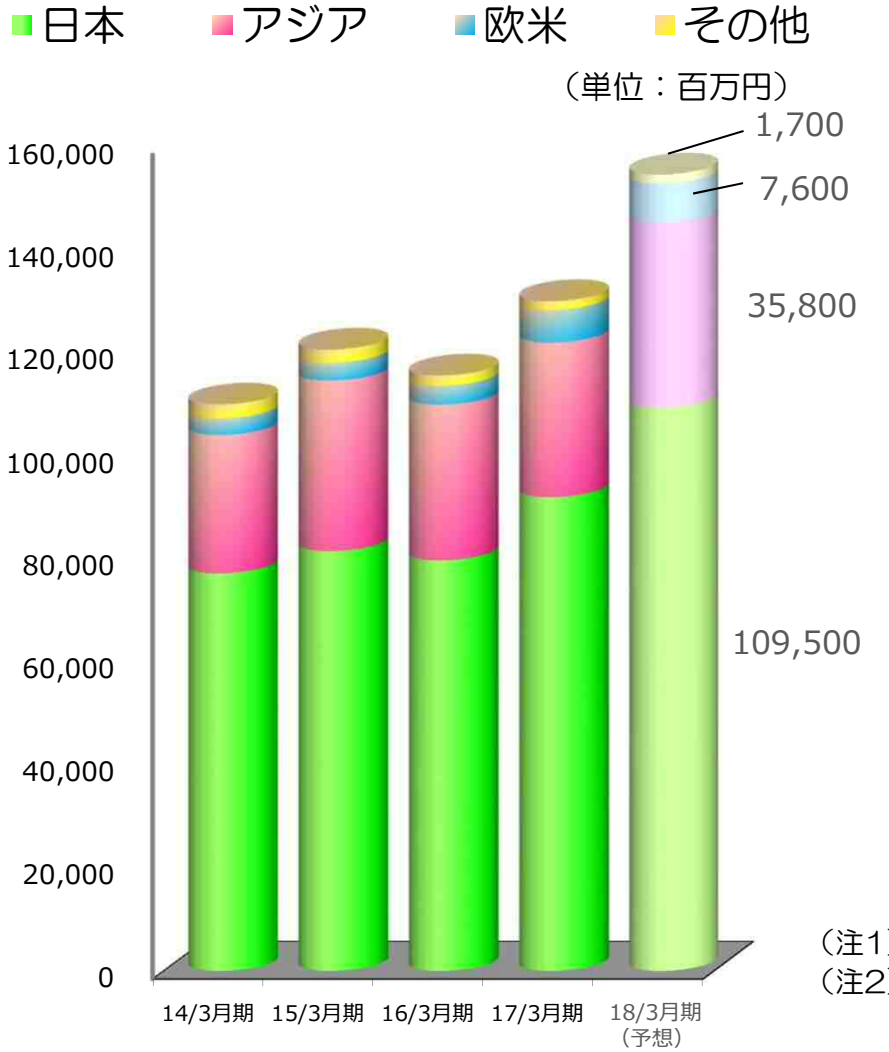


■point

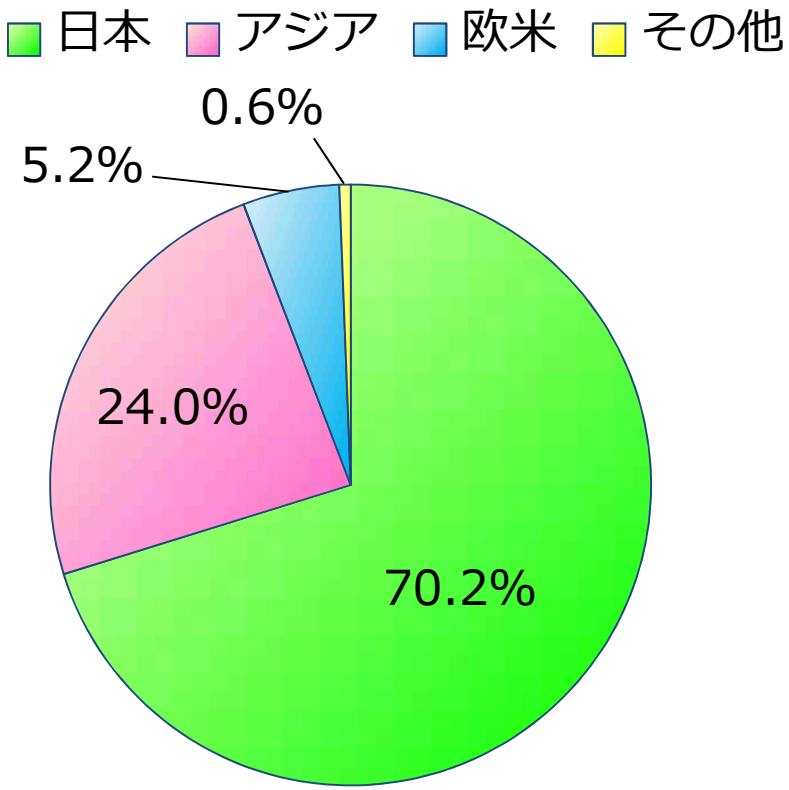
・電子部品業界向けの生産設備の販売が増加
・FPD（フラットパネルディスプレイ）関連業界向けにおいては搬送設備の販売が増加
・FPD関連業界向けの生産設備の販売は一部減少

セグメントの概要

■売上高（注1）



■売上高構成比率（18/3月期第2四半期）（注2）



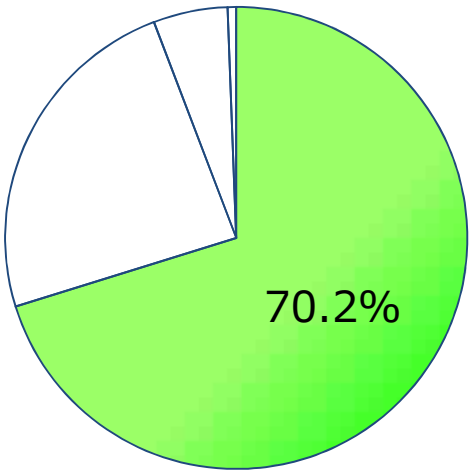
（注1）セグメント間の内部売上高又は振替高を含む売上高
（注2）外部顧客に対する売上高

セグメントの概要【日本】

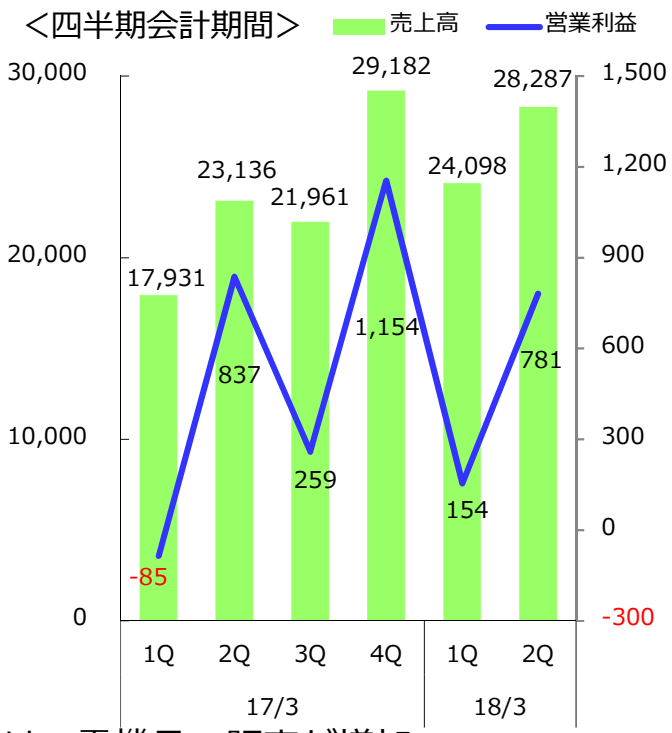
■売上高
当第2四半期累計期間　52,385百万円（前期比 27.6%増）
当第2四半期会計期間　28,287百万円（前期比 22.3%増）

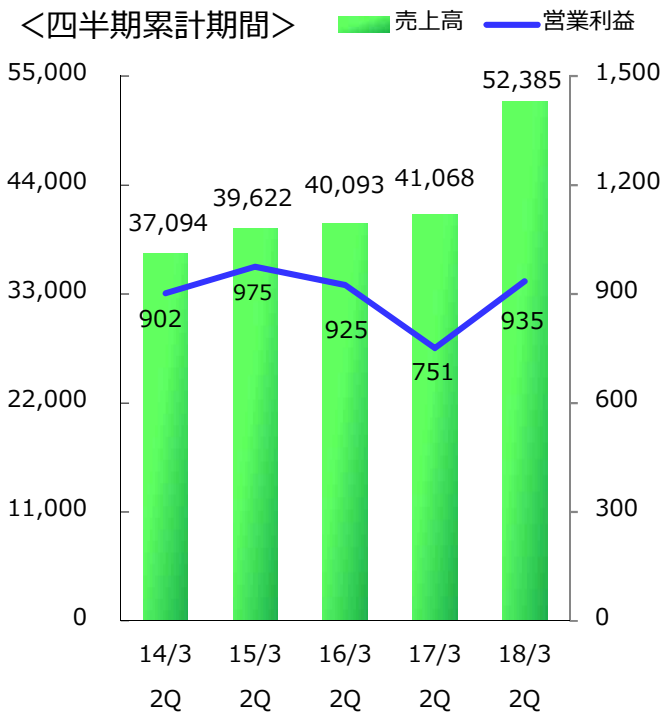
■営業利益
935百万円（前期比 24.5%増）
781百万円（前期比　6.7%減）

■売上高構成比率（注2）
（当第2四半期累計期間）



■売上高・営業利益推移表（注１）（単位：百万円）





■point
・産業機械業界の製造設備向けの電機品の販売が増加
・自動車関連業界、産業機械業界向けの電子部品の販売が増加
・社会インフラ設備向けの電子機器の販売が増加・電子部品業界向けの生産設備の販売が増加
・FPD関連業界向けの搬送設備の販売が増加、生産設備の販売は一部減少

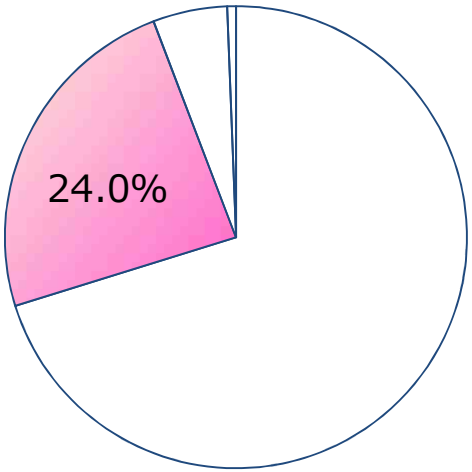
（注1）セグメント間の内部売上高又は振替高を含む売上高
（注2）外部顧客に対する売上高

セグメントの概要【アジア】

■売上高
当第2四半期累計期間　17,734百万円（前期比 49.7%増）
当第2四半期会計期間　9,624百万円（前期比 58.6%増）

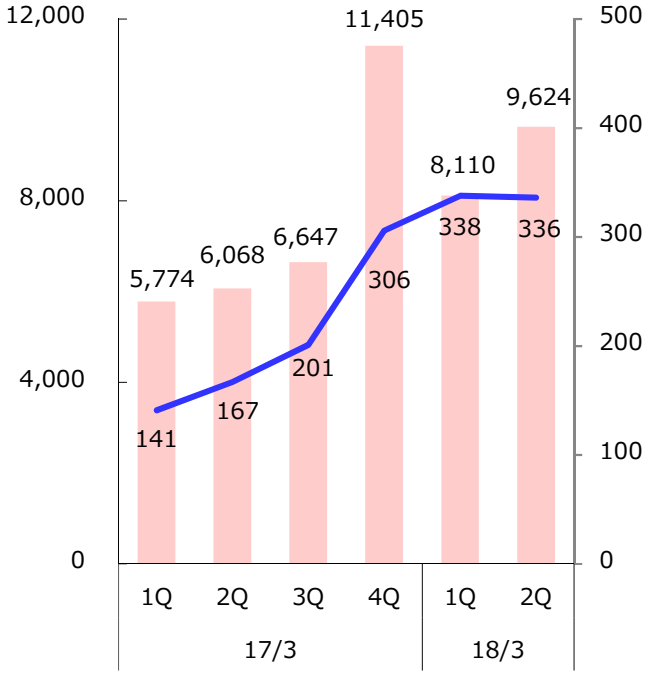
■営業利益
674百万円（前期比 118.3%増）
336百万円（前期比 101.0%増）

■売上高構成比率（注2）
（当第2四半期累計期間）

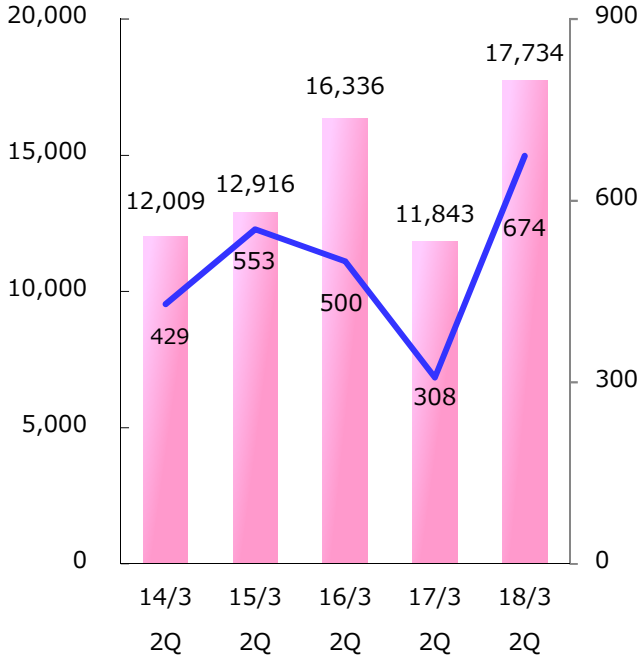


■売上高・営業利益推移表（注１）
（単位：百万円）

<四半期会計期間>



<四半期累計期間>



■point
・産業機械業界向けの電子部品の販売及び電機品の販売が増加

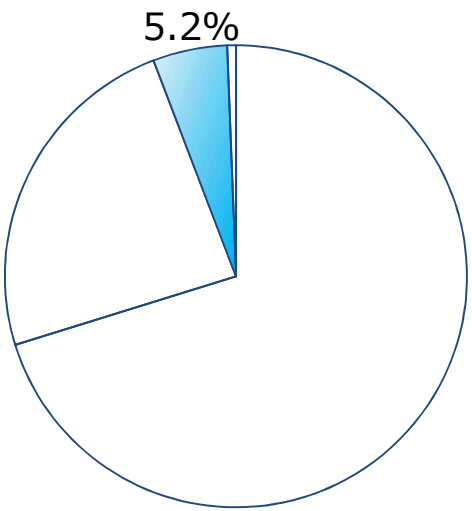
（注1）セグメント間の内部売上高又は振替高を含む売上高
（注2）外部顧客に対する売上高

セグメントの概要【欧米】

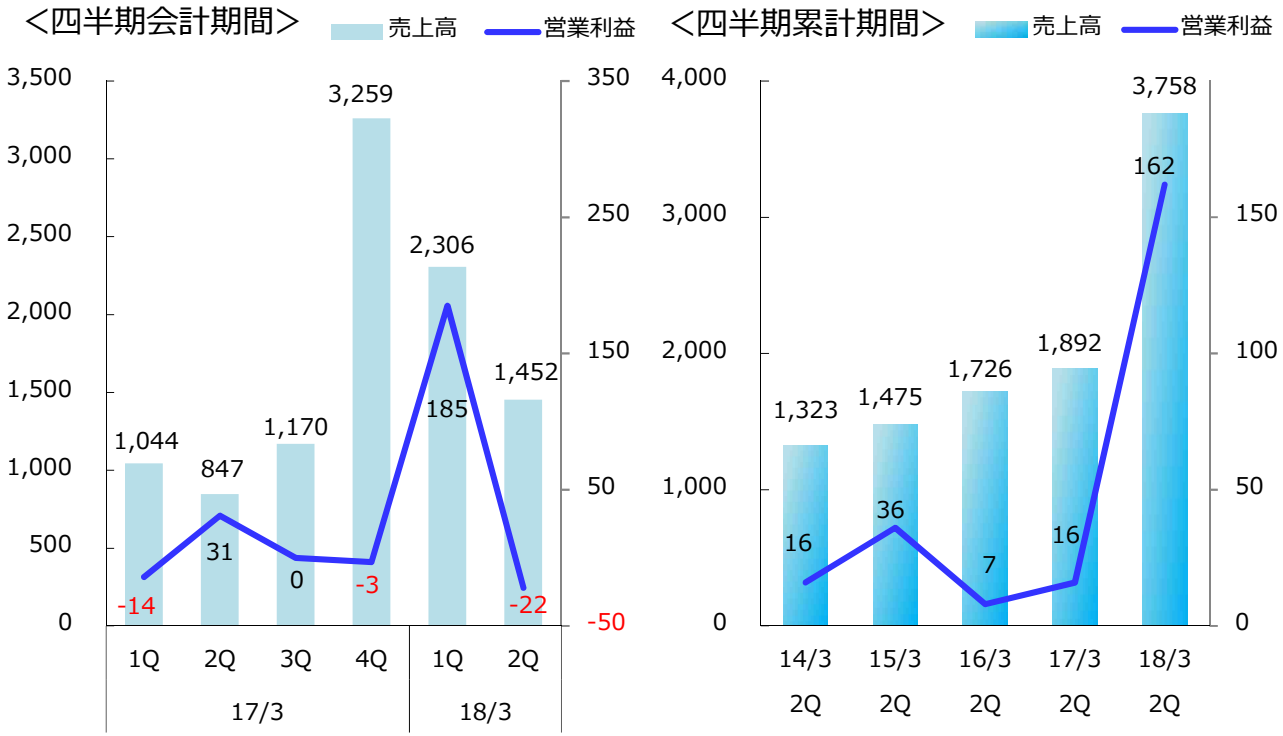
■売上高
当第2四半期累計期間　3,758百万円（前期比　98.6%増）
当第2四半期会計期間　1,452百万円（前期比　71.3%増）

■営業利益
162百万円（前期比 868.1%増）
△22百万円（前年同期は営業利益31百万円）

■売上高構成比率（注2）
（当第2四半期累計期間）



■売上高・営業利益推移表（注１）　（単位：百万円）

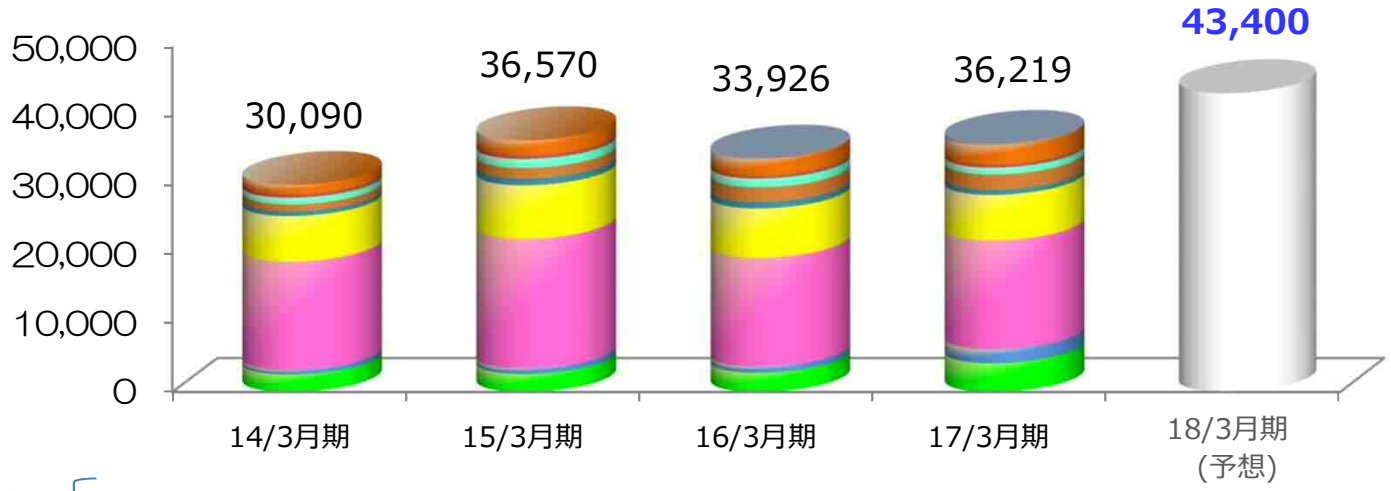


■point
・FPD関連業界向けの電機品の販売及びアミューズメント向けの電子部品の販売が増加

（注1）セグメント間の内部売上高又は振替高を含む売上高
（注2）外部顧客に対する売上高

海外現地法人売上高推移

（単位：百万円）



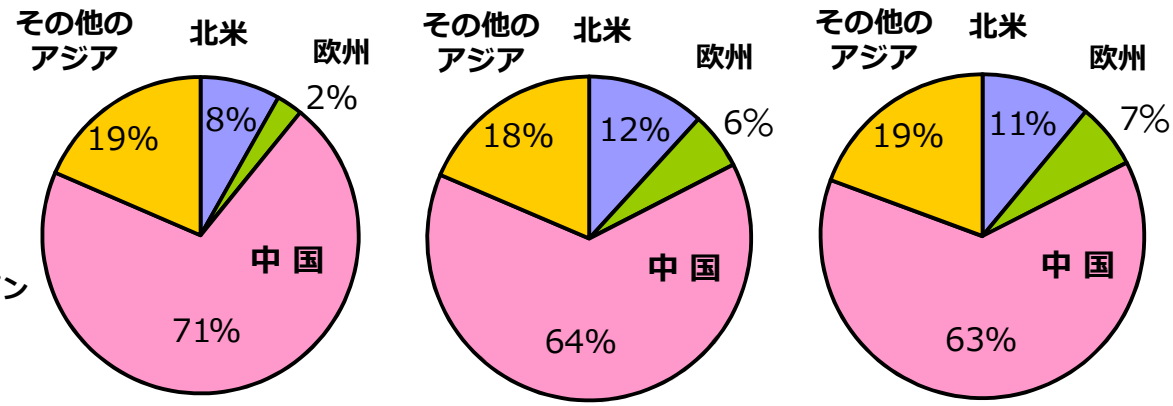
ベトナム
インドネシア
メキシコ
タイ
マレーシア
シンガポール
台湾
深圳
香港
上海
ヨーロッパ
アメリカ

		14/3月期	15/3月期	16/3月期	17/3月期	18/3月期(予想)
（参考）主な通貨の為替レート	1米ドル	105.39円	120.55円	120.61円	116.49円	**110.00円**
	1ユーロ	145.05円	146.54円	131.77円	122.70円	**118.00円**
	1中国元	17.29円	19.70円	18.57円	16.79円	**16.10円**
海外事業の売上高比率		29.7 %	32.9 %	32.1 %	31.1 %	31.2 %

海外売上高構成

2016年3月期　2017年3月期　2018年3月期（予想）

- 北米　・・・アメリカ、メキシコ
- 欧州　・・・ヨーロッパ
- 中国　・・・上海、香港、深圳
- その他のアジア　・・・シンガポール、台湾、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム



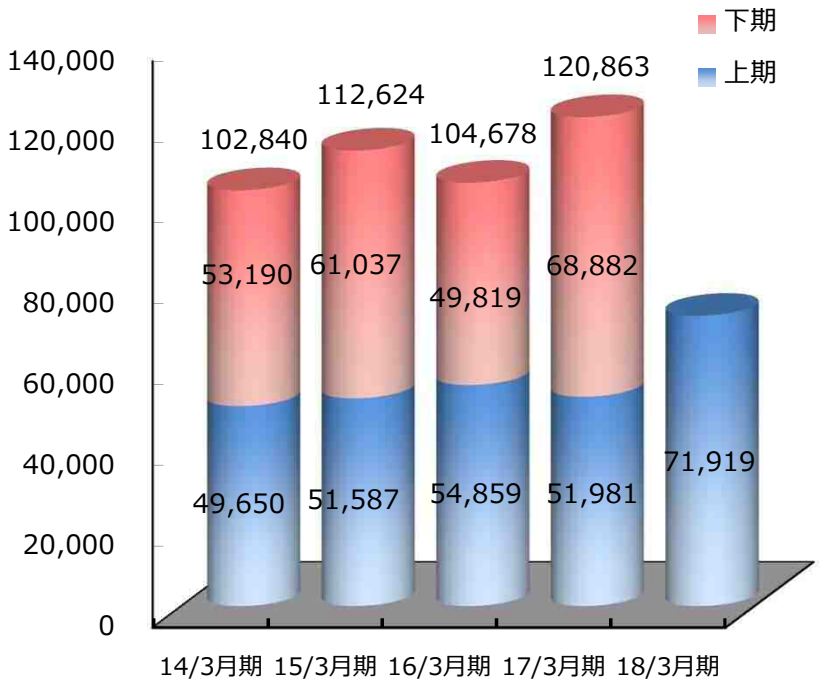
受注高・受注残高の推移（連結）

（単位：百万円）

	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間	増減額	対前年同四半期増減率
受注高	51,981	71,919	19,938	38.4%
受注残高	18,562	25,410	6,847	36.9%

過去最高の受注高・受注残高

■受注高　（単位：百万円）



■受注残高　（単位：百万円）

2018年3月期第2四半期　（個別）業界別売上高・主要仕入先

得意先（業界）	対前年同期増減（矢印）　及び　シェア（%）					
	2016/3 2Q		2017/3 2Q		2018/3 2Q	
ＦＡ・産業機器	↗	30.3%	→	29.2%	↗	27.9%
自動車	↗	7.0%	↗	10.3%	↗	12.9%
半導体・液晶	↘	10.5%	↗	12.1%	↗	10.8%
情報・通信	↘	4.0%	→	4.1%	↗	4.7%
ロボット・マウンター	↘	2.3%	↗	2.6%	↗	3.1%
社会インフラ	↘	3.2%	↗	3.7%	→	2.9%
アミューズメント	→	9.3%	↘	2.9%	→	2.3%
工作機械	↗	2.4%	↘	1.9%	↗	2.1%
環境・エネルギー	↘	2.7%	↘	2.0%	↘	1.3%
医療機器	↗	1.6%	↘	1.5%	↗	1.2%
セキュリティ	↗	0.8%	↗	1.2%	↗	1.0%
食品	↘	0.1%	↗	0.2%	↗	0.3%

（業界）は主要な得意先を業界別に分類（2017/4更新）

仕入先
㈱安川電機
リコーインダストリアルソリューションズ㈱
オムロン㈱
ミネベアミツミ㈱
TDKラムダ㈱
フエニックス・コンタクト㈱
ケル㈱
スタンレー電気㈱
JABIL CIRCUIT LTD.
シーメンス㈱
その他の仕入先で約60%（約1,900社）

連結キャッシュ・フロー

・現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ750百万円増加し、
当第２四半期連結会計期間末は7,026百万円となりました。

（単位：百万円）

	当期	主な要因
営業ＣＦ	△1,301	減少要因：売上債権の増加 たな卸資産の増加 法人税等の支払 増加要因：税金等調整前四半期純利益 仕入債務の増加
投資ＣＦ	△66	減少要因：有形固定資産の取得による支出
財務ＣＦ	2,144	増加要因：長期借入れによる収入 減少要因：配当金の支払
現金及び現金同等物に係る換算差額	△26	―――
現金及び現金同等物四半期末残高	7,026	―――

（連結）貸借対照表比較

（単位：百万円）

	前連結会計 年度末	当第2四半期 連結会計期間末	増減額	主な要因
資産合計	64,816	70,805	5,989	商品及び製品、 投資有価証券の増加
負債合計	41,178	45,068	3,889	電子記録債務及び 長期借入金の増加
純資産合計	23,637	25,737	2,099	利益剰余金及び その他有価証券評価 差額金の増加

配当金の推移

期	第2四半期末	期末	年間	配当性向 連結
14/3月期	１０円	１２円	２２円	13.5%
15/3月期	１２円	１４円	２６円	15.1%
16/3月期	１４円	１４円	２８円	23.8%
17/3月期	１４円	１４円	２８円	24.6%
18/3月期	１４円	１４円 (予想)	２８円 (予想)	14.6%

※当社は、株主の皆様に対して安定した配当を継続するとともに、業績の進展状況により増配や株式分割などを実施して行くことを基本方針としています。

- 2018年3月期 第2四半期 決算概要
- 2018年3月期 業績予想
- 第9次中期経営計画(Challenge 1500)進捗

2018年3月期 通期 業績予想について（連結）

（単位：百万円）

	2017年3月期 実績	2018年3月期 業績予想	対前期増減率
売　上　高	116,611	139,000	19.2%
営業利益	3,014	3,500	16.1%
経常利益	3,215	3,800	18.2%
当期純利益 （※）	1,584	2,650	67.3%

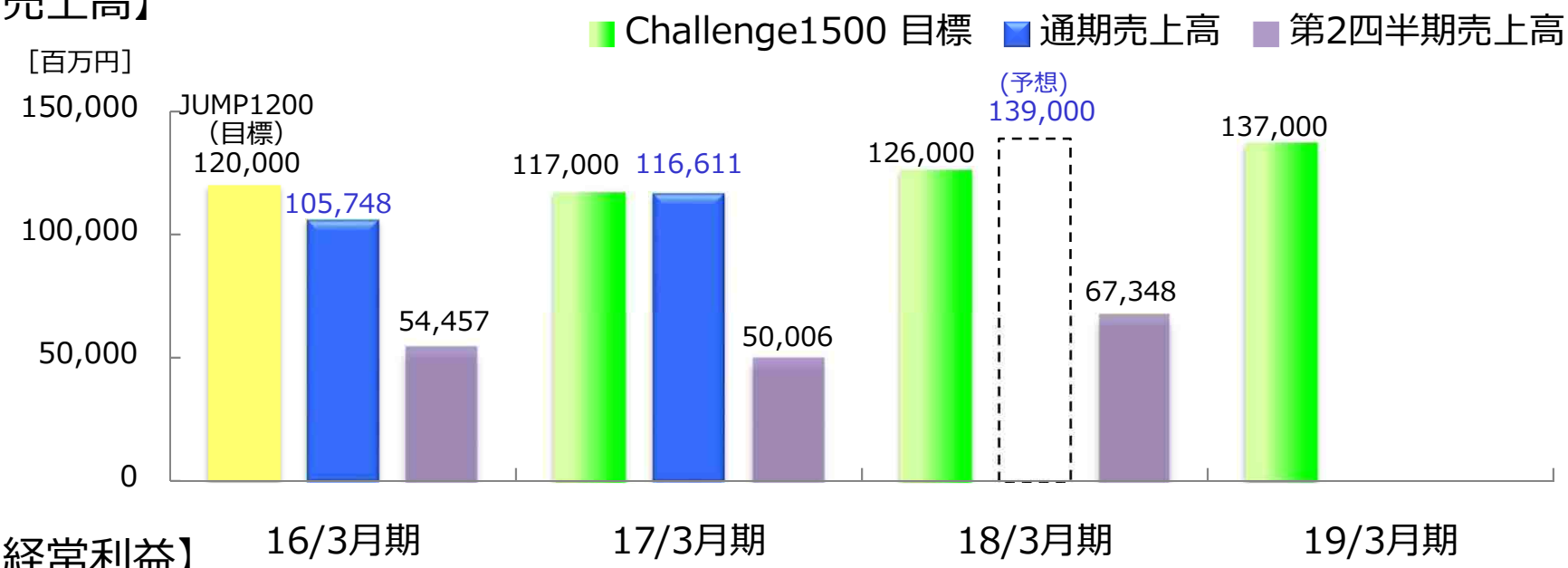
【2018年3月期の見通し】
当社グループの関連しております産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界におきましては、スマートフォン向け及び自動車向けの需要が堅調を維持しており、半導体関連業界・産業機械業界につきましても、ロボットや半導体製造装置等の市場の好調が続いております。
このような環境の中、通期連結業績予想につきましては、前回予想を上回る水準で推移していることから、2017年7月28日発表の通期業績予想より修正しております。

（※）親会社株主に帰属する当期純利益

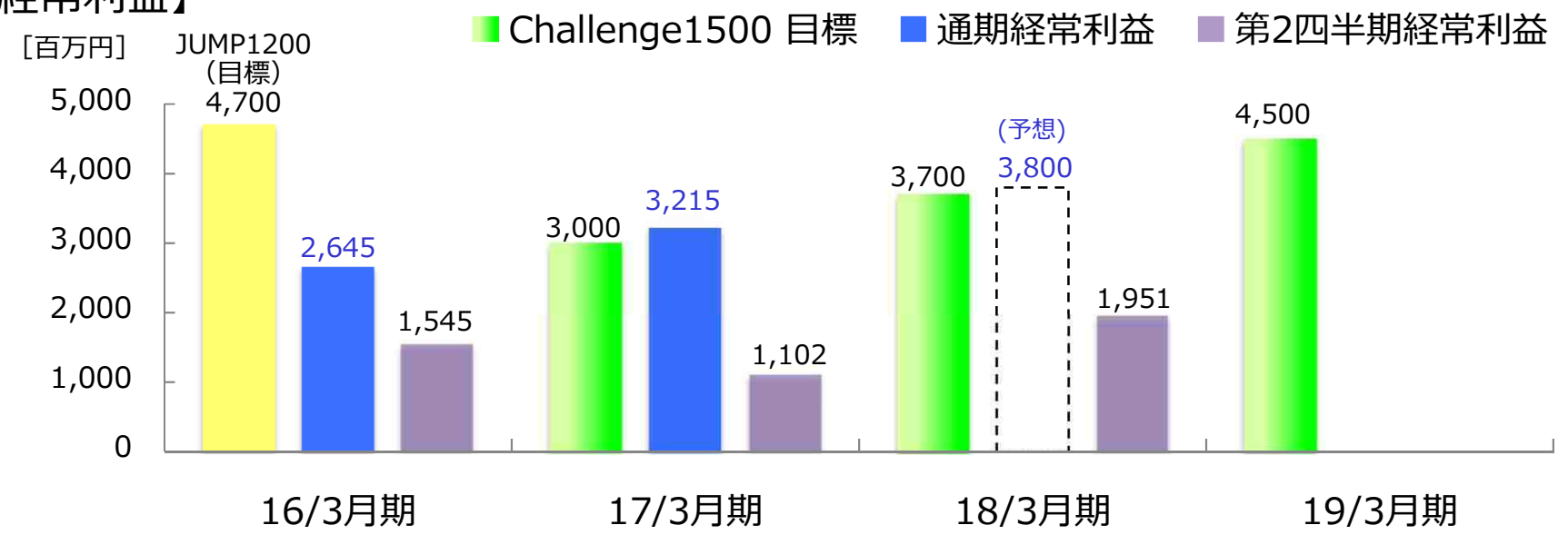
- 2018年3月期 第2四半期 決算概要
- 2018年3月期 業績予想
- 第9次中期経営計画(Challenge 1500)進捗

売上高及び経常利益推移（連結）

【売上高】



【経常利益】



エンジニアリング事業

自動化システム、省エネ製品を提案しお客様のものづくりを支援します

- ＩＣＴ技術を活用した「未来のものづくり」を目指す
- ロボットを活用した 自動化システムの提案
- 省エネや省電力を目指したシステム提案

（トピックス）

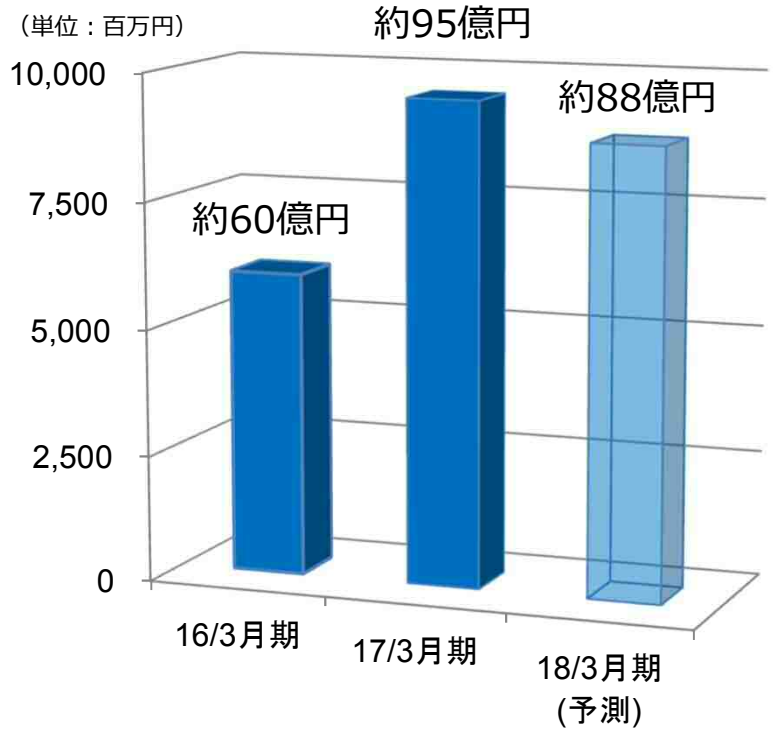
2017年4月
メカトロニクス営業部・機械システム営業部をFAシステム営業部へ統合

（目的）
電機・機械を統合することで総合力を高め、エンジニアリング事業のさらなる強化を図る

2017年10月
エンジニアリング部の組織を再編

（目的）
より社内連携を図る為に、組織ごとの役割を明確にしエンジニアリング事業を積極的に提案できる体制が整う
（ＩｏＴ推進課、監視制御推進課、自動認識推進課、電機技術課、技術サービス課）

エンジニアリング事業　仕入高予測



2017/3月期　大型物件あり

グローバルＳＣＭソリューション事業

お客様の物流業務を包括的に受託し、最適ソリューションで資材調達から
生産、販売、リサイクルに至る一連の企業活動における物流合理化による
お客様のコア事業の拡大支援を実現します

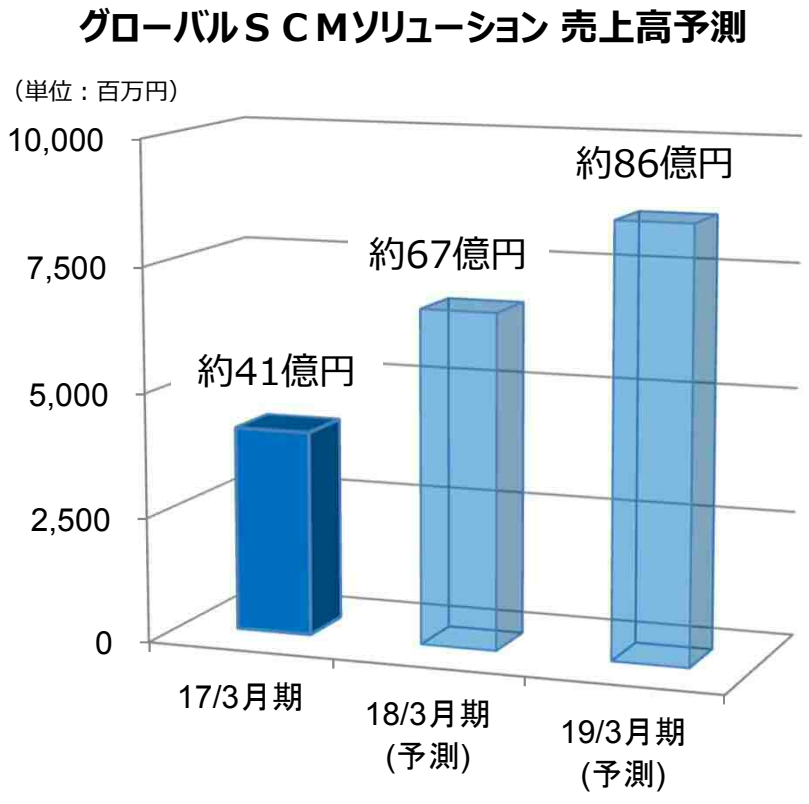
- 生産移管などお客様のものづくりの支援（移管作業の効率運用）
- グローバルネットワークを駆使し、最適商流・調達を提案
- 現地調達の支援（現地メーカーの紹介と工場監査の支援）

【商談事例】

◆ 航空機内AVシステム向けタッチパネル
部材を台湾から日本へ
（OUT－IN）

◆ 家庭用ミシンメーカー用基板実装
部材を中国からベトナムへ
（OUT-OUT）

◆ VMI倉庫運用案件
部材を日本からシンガポールへ
（IN-OUT）



以上のように、高い成長性・収益性・安定性を求めて、経営に努力してまいりますので、今後も一層のご支援を賜りたくお願い申し上げます。